

玻璃载片

具有独特材料特性的系列产品
适用范围广泛

几十年来,肖特在高品质的玻璃基板和晶圆产品方面声名远播,为高科技行业(如:半导体和光电子、汽车、科研和生物技术)提供了多种多样的产品。我们的专家为客户量身定制解决方案,提供专业的技术支持。

玻璃载片具有从紫外到红外的高透射率,满足多种解键合方案的需求。在半导体应用中,玻璃晶圆作为与硅晶圆临时键合和解键合的载体材料正变得愈发重要,例如

- 3D 集成电路
- IGBT 和
- 扇外型晶圆级封装

肖特玻璃系列产品具有广泛的热膨胀系数 (CTE) 范围,满足客户设备材料的需求

基于广泛的材料选择,我们可以满足客户的不同需求。



高品质玻璃原料



广泛产品系列



多种产品形态



键合&解键合

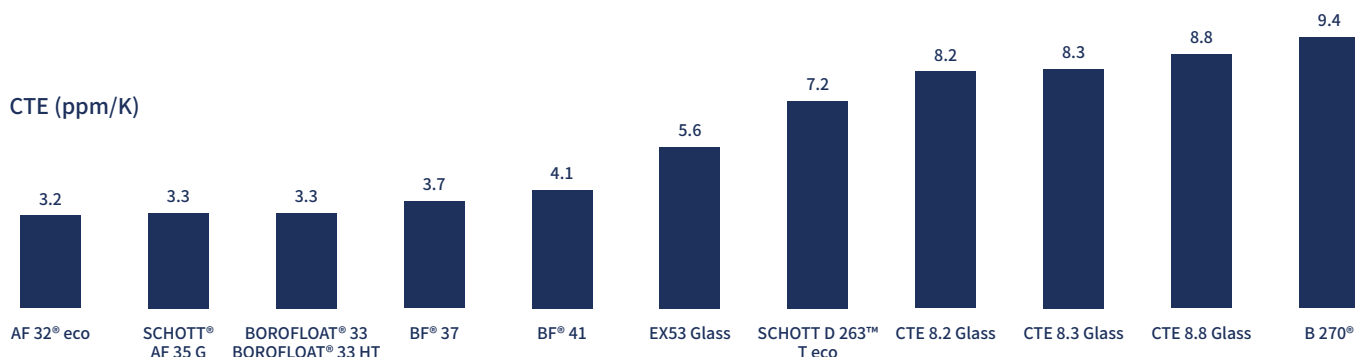


可用于后端制程

优势一览

- 极低的总厚度变化 (TTV) 和卓越的平整度
- 从紫外到红外的优异光学透射率
- 高度耐酸、耐碱和耐水性
- 适用于临时键合
- 非常适合高精度 3D 集成电路、硅薄化制程
- 扇外型晶圆级封装的理想基板
- 玻璃晶圆满足直接在半导体制程中使用,可激光打标,无尘室中包装
- 可根据客户要求提供技术支持

CTE (ppm/K)



SCHOTT

凝智慧 享未来 肖特科技

玻璃载片

我们的玻璃载片经过高品质加工，赢得客户信任

极低的 TTV 扩展了应用范围

基於我們的能力,肖特玻璃载片晶圓和载板可滿足市場的最高要求。

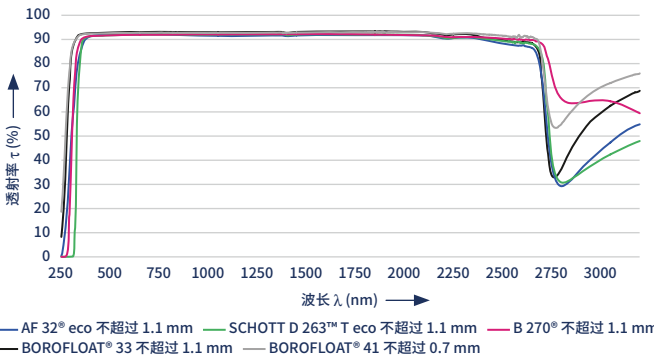
几何特性	数值
超低的总厚度变化 (TTV)	< 2.0 μm (标准) < 0.5 μm (高级)
精确的厚度公差	$\pm 5 \mu\text{m}$ (标准) $\pm 2.5 \mu\text{m}$ (高级)
翘曲 (与材料和厚度相关)	8" < 30 μm 12" < 50 μm
表面质量 (与材料和厚度相关)	划伤/凹坑: 40/20 (标准) 20/10 (高级)

肖特玻璃载片晶圓和基板可提供多種常用晶圓和面板規格

形状	规格*
晶圓	6", 8", 12" [150 - 300 mm]
基板	100 x 100 mm - 650 x 650 mm
厚度	0.1 - 3.0 mm

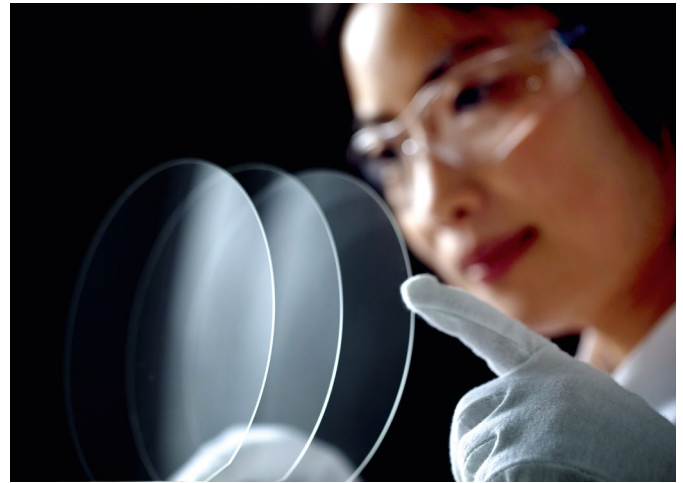
* 可根据要求提供其他尺寸

光谱透射率 $\lambda = 250 \text{ nm}$ 到 $3,200 \text{ nm}$

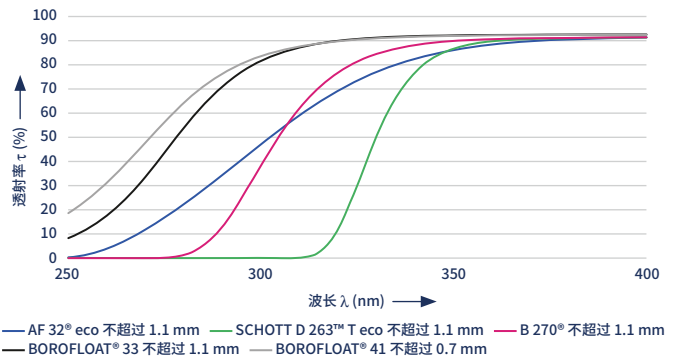


载片晶圓和基板的标准規格

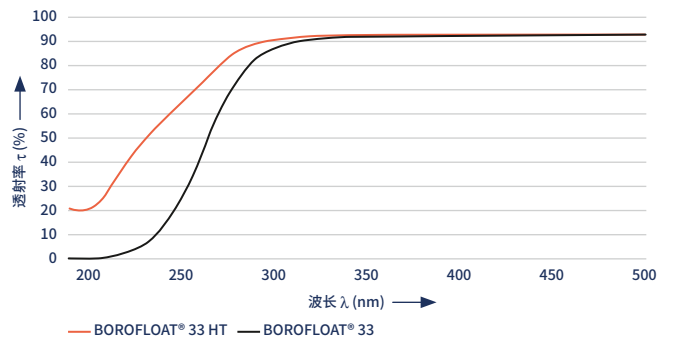
- 平边/凹槽: 符合 SEMI 标准
- 激光打标: 条形码/特殊编码
- 清洗: 超声波清洗和 ISO6 标准的清洗室
- 包装: 检验, 按照 ISO6 标准在晶圓盒 (FOSB, RTU 等) 中包装



光谱透射率 $\lambda = 250 \text{ nm}$ 到 400 nm



光谱透射率 $\lambda = 200 \text{ nm}$ 到 500 nm



精密加工使多种载片解决方案得以实现

通过精密加工,我们能够实现多种产品形式,包括按尺寸切割、非抛光和抛光的晶圓和基板。

schott.com

肖特(上海)精密材料和设备国际贸易有限公司, 上海市虹梅路1801号凯科国际大厦301室, 邮编:200233
电话:+86 (0)21 3367 8000, 传真:+86 (0)21 3367 8080, info.china@schott.com

SCHOTT

凝智慧 享未来 肖特科技

carbon neutral
naturechina.com | 04-7742210
print production

MIX
FSC
FSC® C006855
www.fsc.org

CHINESE 10/2024 kn/nino Printed in Germany